

2021年3月期（2020年4月～2021年3月） 東京エレクトロン 決算説明会

2021年4月30日

内容：

- 2021年3月期 連結決算の概要 取締役 専務執行役員 布川 好一
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルスの影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。したがって、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

2021年3月期 連結決算の概要

2021年4月30日

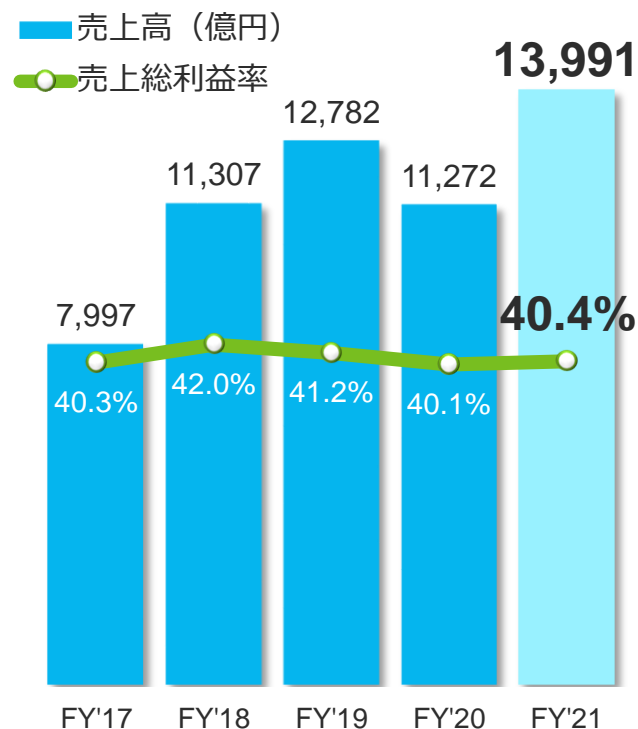
布川 好一

取締役 専務執行役員 Global Business Platform本部長

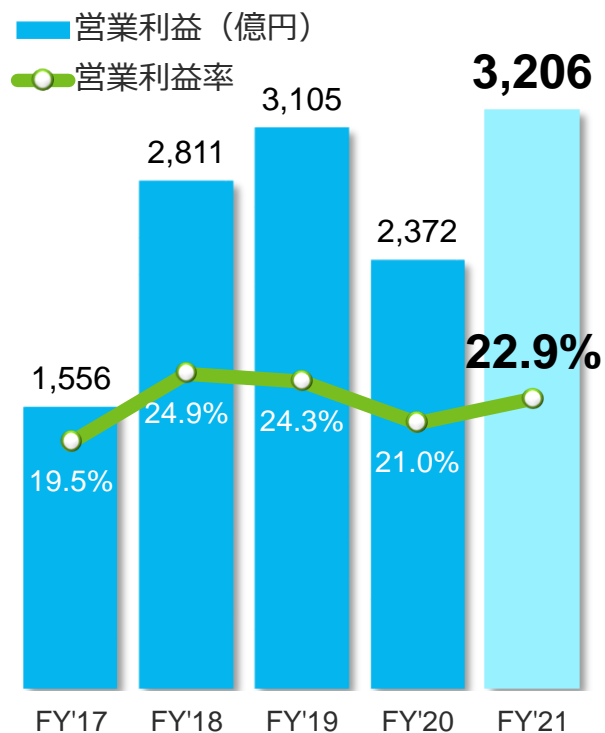


FY2021（2020年4月～2021年3月）財務ハイライト

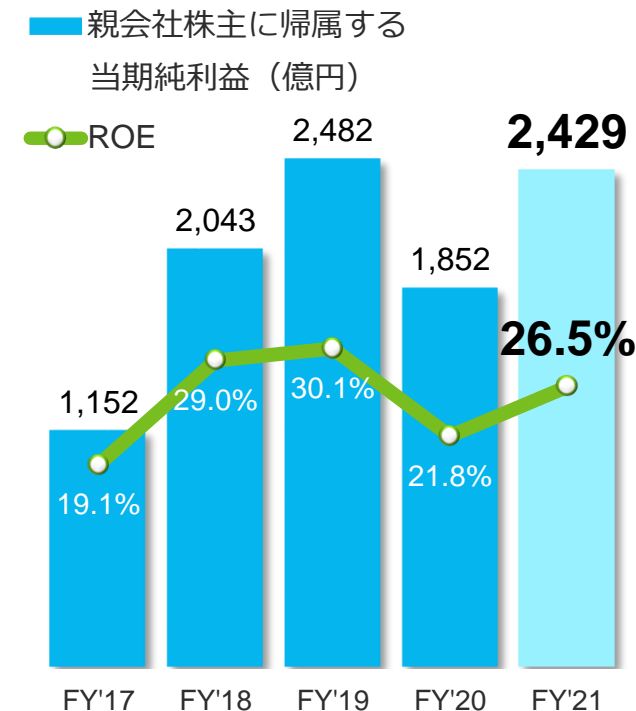
売上高と売上総利益率



営業利益と営業利益率



親会社株主に帰属する 当期純利益とROE



- SPE*1およびFPD*2需要の拡大を受け、前期比+24%の増収
- 売上高・売上総利益・営業利益が過去最高を更新

損益状況

(億円)

	FY2020	FY2021	対前期 増減	(ご参考) 2021年1月28日発表 のFY2021予想
売上高	11,272	13,991	+24.1%	13,600
SPE	10,609	13,152	+24.0%	12,800
FPD	660	837	+26.8%	800
売上総利益 下段：売上総利益率	4,519 40.1%	5,649 40.4%	+25.0% +0.3pts	5,490 40.4%
販管費	2,146	2,442	+13.8%	2,430
営業利益 下段：営業利益率	2,372 21.0%	3,206 22.9%	+35.1% +1.9pts	3,060 22.5%
税金等調整前当期純利益	2,446	3,170	+29.6%	3,060
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,852	2,429	+31.2%	2,300
1株当たり当期純利益 (円)	1,170.57	1,562.20	+33.5%	1,479.06
研究開発費	1,202	1,366	+13.6%	1,350
設備投資額	546	538	-1.5%	560
減価償却費	291	338	+16.3%	380

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

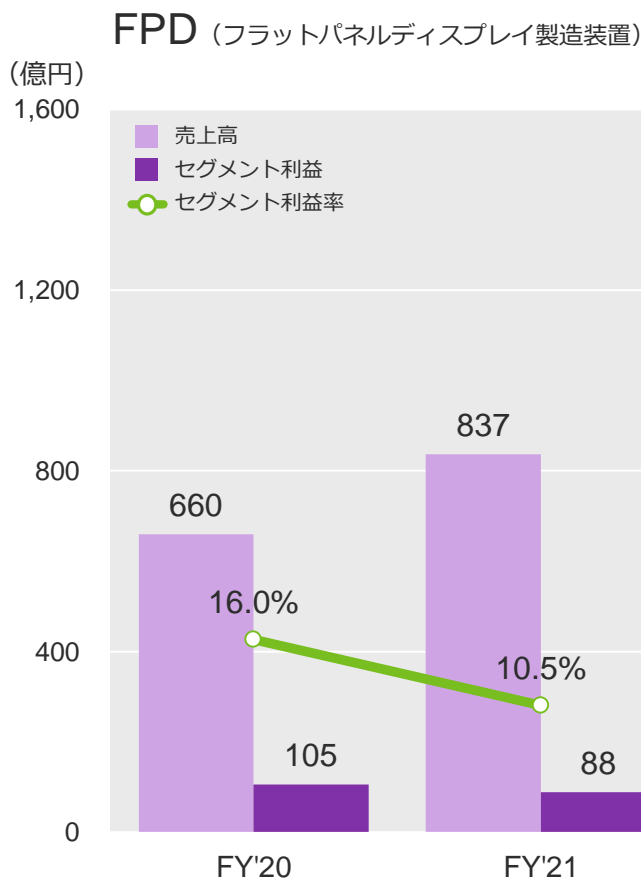
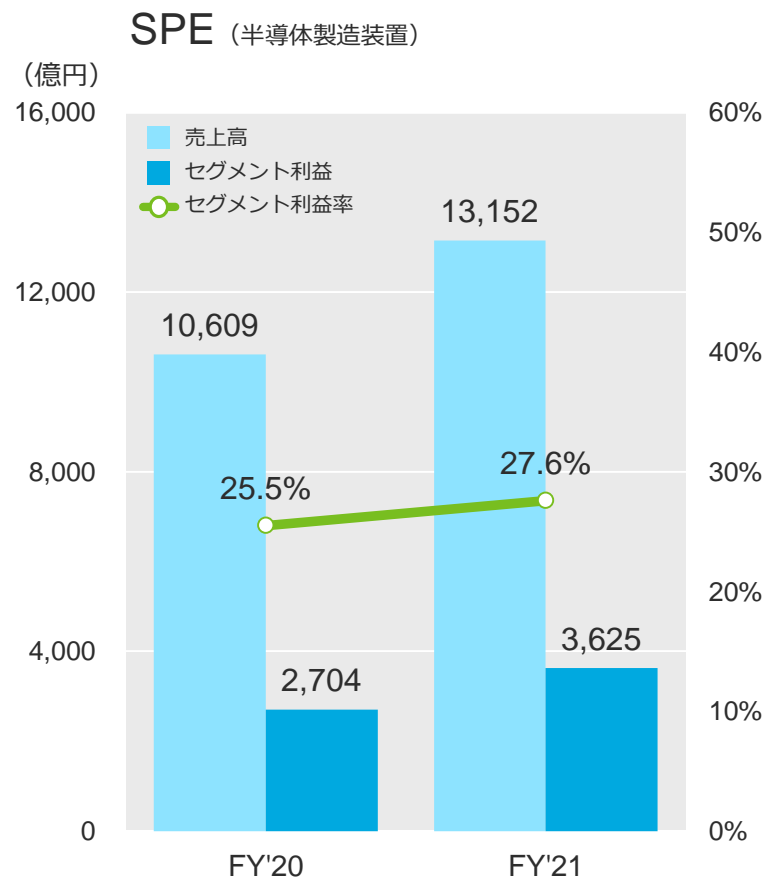
損益状況（四半期）

(億円)

	FY2020	FY2021				対FY2021 Q3 増減
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
売上高	3,233	3,148	3,533	2,917	4,392	+50.6%
SPE	3,089	3,037	3,316	2,643	4,154	+57.2%
FPD	143	110	216	273	237	-13.3%
売上総利益	1,298	1,284	1,363	1,219	1,782	+46.2%
下段：売上総利益率	40.2%	40.8%	38.6%	41.8%	40.6%	-1.2pts
販管費	597	546	627	590	678	+14.9%
営業利益	701	738	735	628	1,103	+75.6%
下段：営業利益率	21.7%	23.5%	20.8%	21.6%	25.1%	+3.5pts
税金等調整前当期純利益	733	746	730	623	1,069	+71.6%
親会社株主に帰属する 当期純利益	571	564	555	461	847	+83.6%
研究開発費	334	301	362	330	371	+12.3%
設備投資額	117	132	149	88	168	+90.4%
減価償却費	86	71	81	88	97	+9.8%

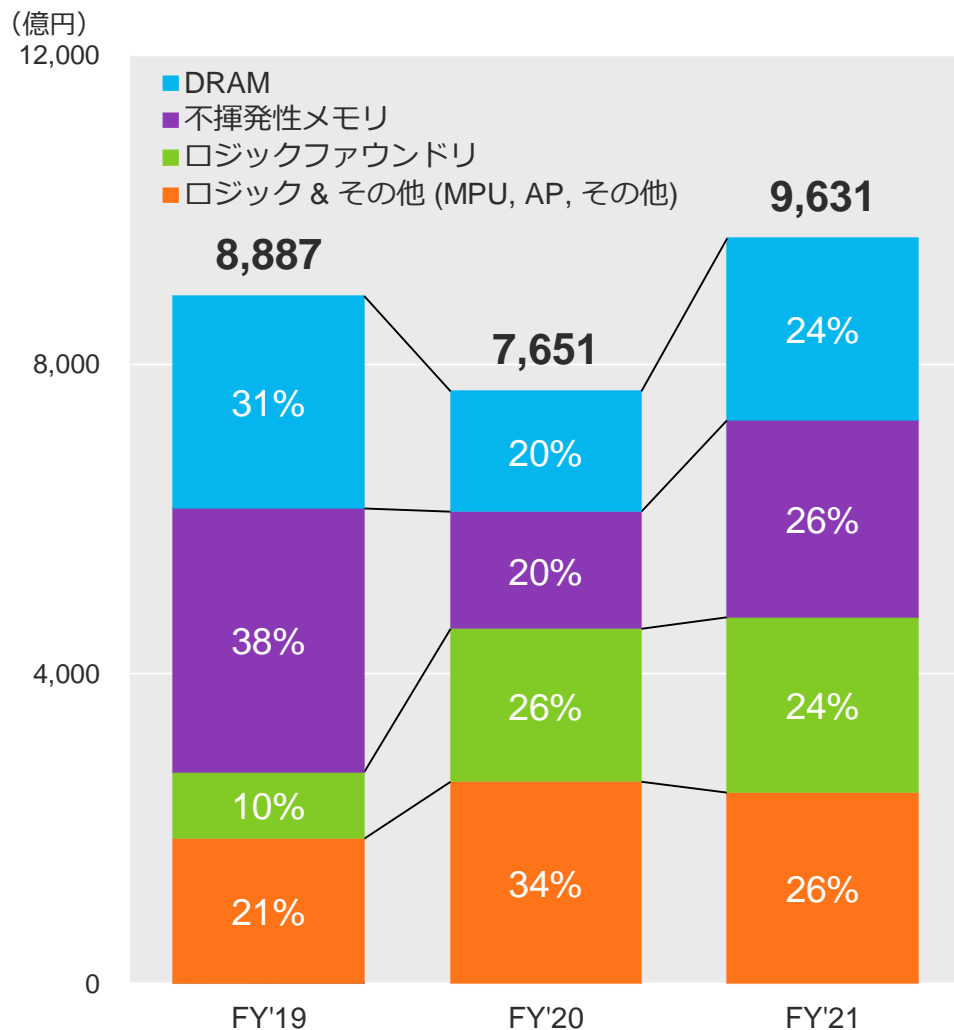
1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

セグメント情報



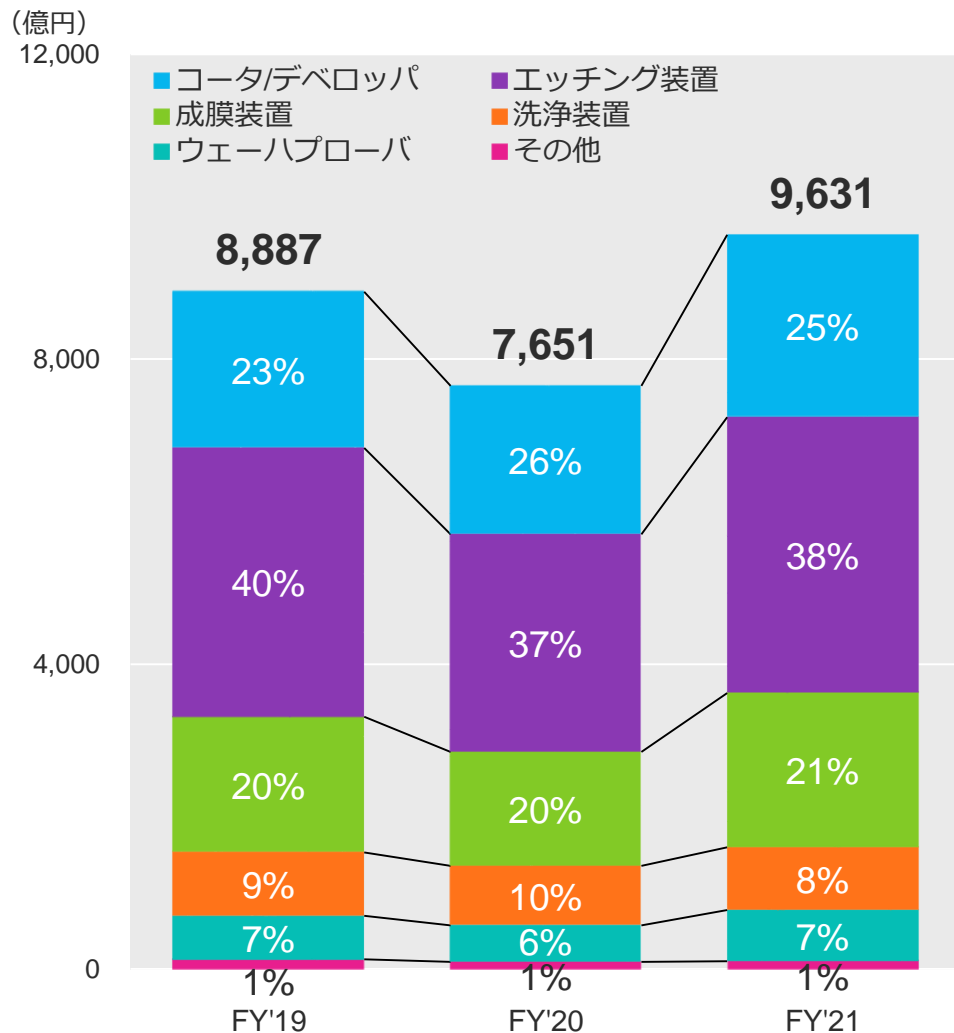
1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究又は要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



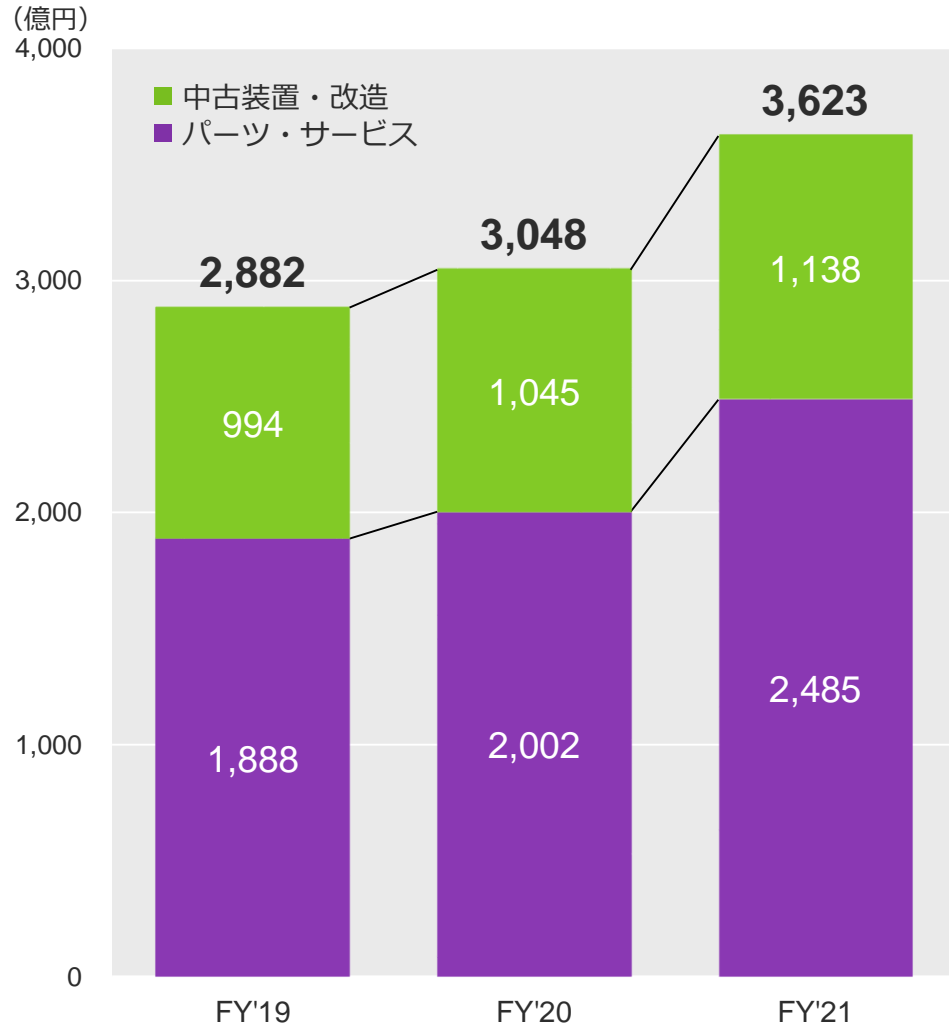
- メモリでは、先端世代における生産能力増強に向けた積極的な投資を背景に、DRAM・不揮発性メモリ向けともに売上が大きく伸長
- ロジック/ファウンドリにおいても、最先端世代向けに加え、14nmから成熟世代に向けた幅広い世代への投資が継続

SPE部門 新規装置 製品別売上構成比



- 不揮発性メモリ向け投資の拡大を背景に、エッチングおよび成膜装置の売上構成比が増加

フィールドソリューション売上高

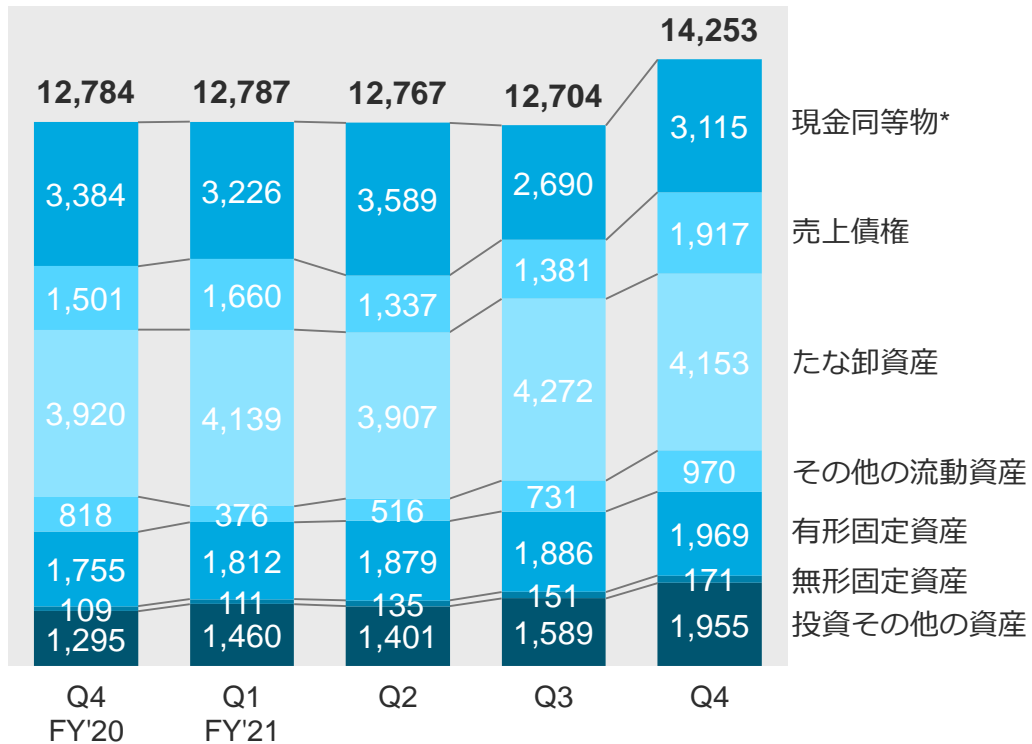


- FY2021 フィールドソリューションの売上高は、前期比+19%の 3,623億円
- インストールベースの増加に加え、顧客工場の高い稼働率を背景に、パーツ・サービスの売上が大きく伸長

貸借対照表（四半期）

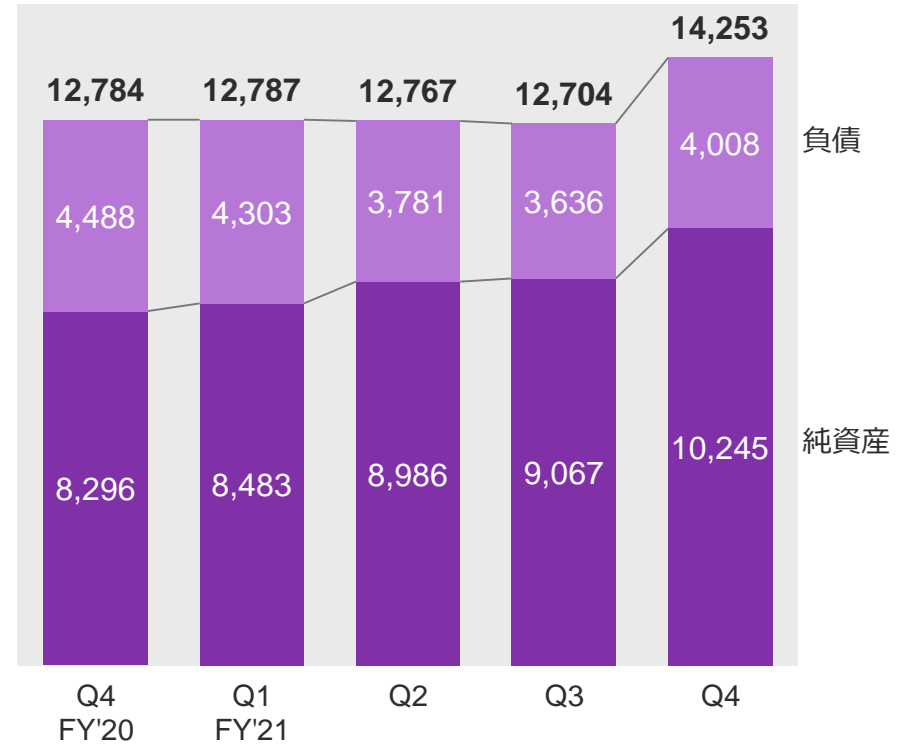
資産

(億円)



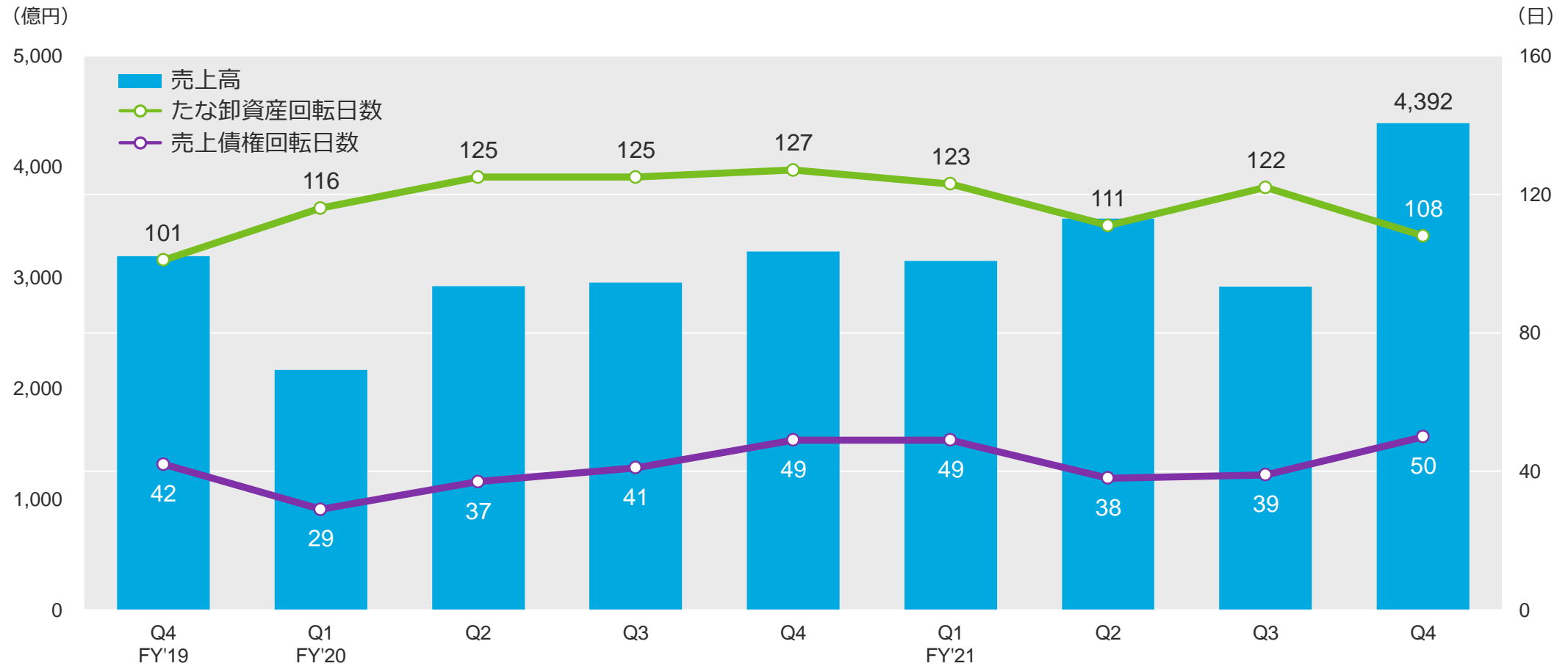
負債・純資産

(億円)



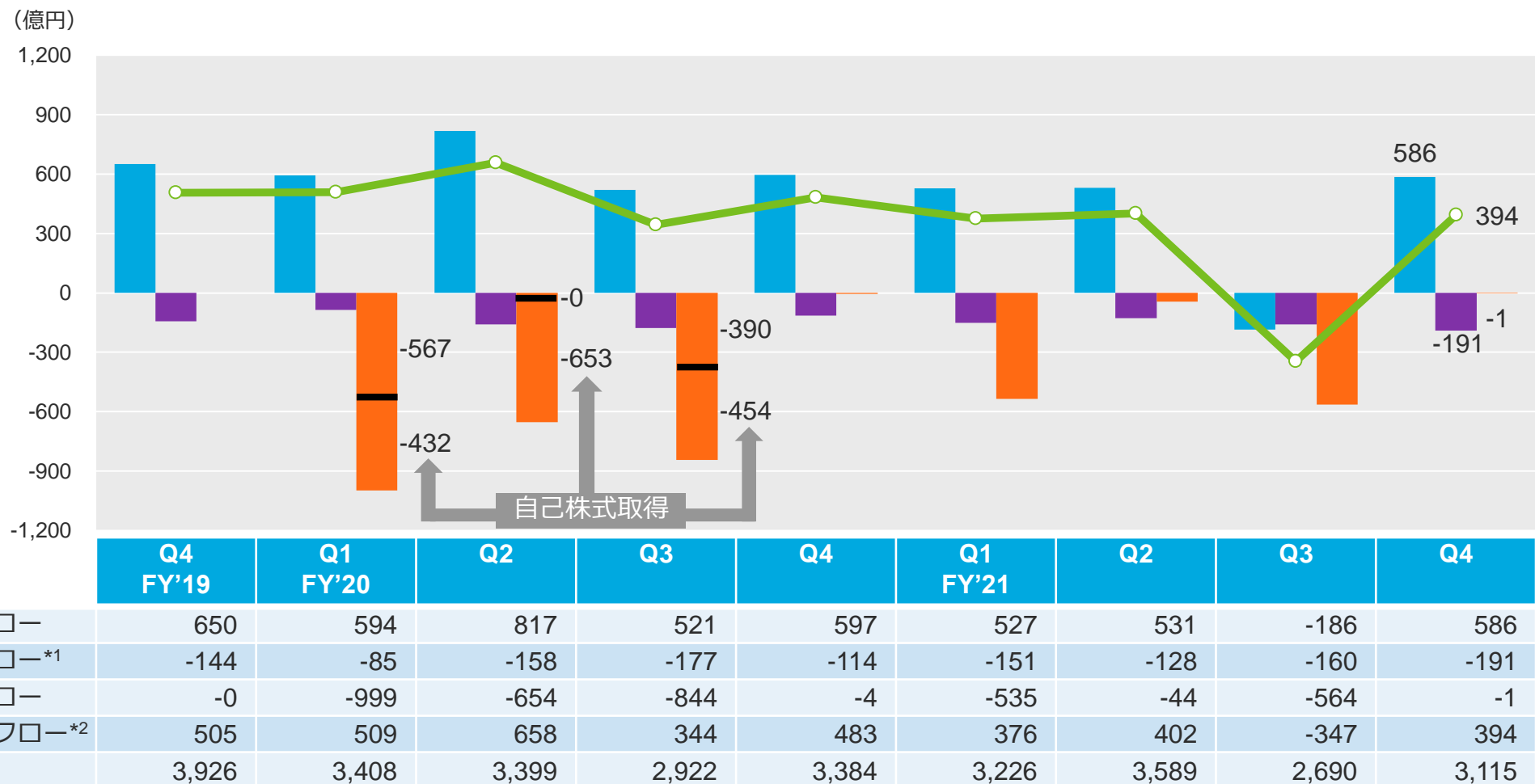
* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

たな卸資産・売上債権の回転日数（四半期）



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12カ月月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー（四半期）



*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

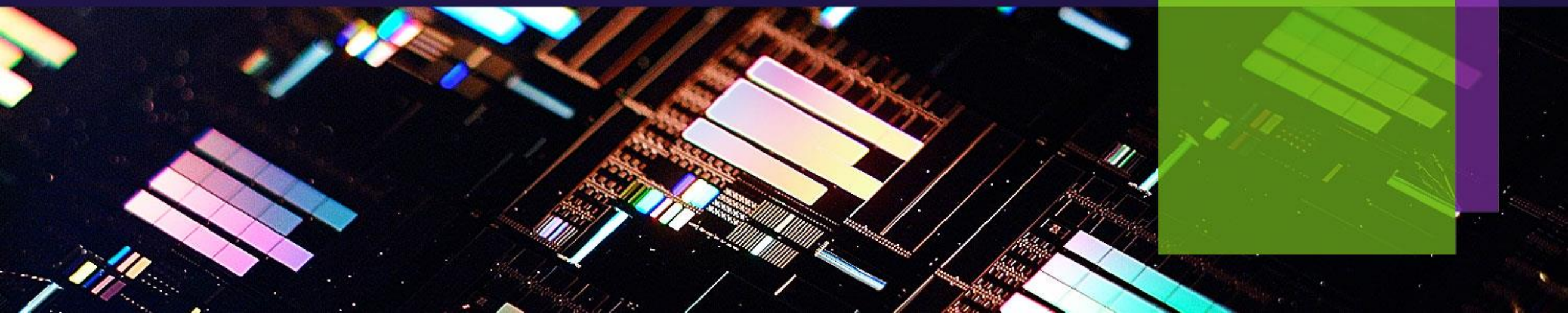
*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

事業環境および業績予想

2021年4月30日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



FY2021 事業ハイライト

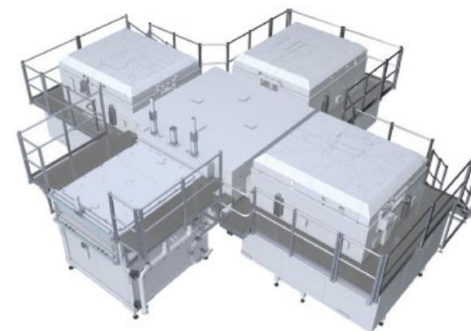
- 業績は予想を上回って着地。売上高、営業利益ともに過去最高を更新
 - COVID-19の環境下においても、事業活動は順調に進捗。
海外現地法人と工場の連携により装置立ち上げを完遂
 - SPE：新製品、新プラットフォームをリリース
 - FPD：高精細プロセス向け新チャンバーPICP™ Proを搭載したエッチング装置をリリース
 - フィールドソリューション：顧客工場の高い稼働率を背景に、引き続き堅調



CELLESTA™ SCD



Episode™ UL



Impressio™ 1800 PICP™ Pro

FY2021 事業ハイライト

- 研究開発費は過去最高に。成長投資を継続
- 東北工場、山梨工場が稼動開始。需要の増加に備えた生産体制を構築
- DX（デジタルトランスフォーメーション）活動を強化。札幌事業所を移転し、TEL デジタル デザイン スクエアをオープン
- 2030年に向けた中期環境目標を改定

東北工場
(2020年7月稼動開始)



山梨工場
(2020年8月稼動開始)



TEL デジタル デザイン スクエア
(2020年11月開設)



CY2021 事業環境（2021年4月時点での見方）

▶ 半導体前工程製造装置(WFE)*1の設備投資

5Gモバイルの普及とデータセンター投資に牽引され、
旺盛なロジック/ファウンドリ投資に加え、メモリ投資も加速。
CY2021は前年比3割程度の成長を見込む

▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程*2向け設備投資

モバイル向けOLED投資は前年比で増加も、大型パネル向けLCD投資は一巡。
今後、OLED投資に牽引され市場の成長が期待できるが、
CY2021は大型パネル向け投資がLCDからOLEDに移行する端境期として、
前年比3割程度の減少を見込む

*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能をもつ基板を製造する工程

CY2021 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

- ロジック/ファウンドリ：前年比30%程度増加
 - 市場環境：情報通信技術の推進に伴うアプリケーションの拡大により、積極的な投資が一層進み、市場成長を牽引
 - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大
- DRAM：前年比45%程度増加
 - 市場環境：5Gモバイル、PC、データセンターの需要の増加により需給が逼迫。高水準の投資を見込む
 - 事業機会：微細化に向けた新たな技術、新たな材料への対応
- 不揮発性メモリ：前年比15%程度増加
 - 市場環境：中長期のビット需要成長に向け、着実な投資が継続
 - 事業機会：高付加価値のエッチング・洗浄工程での差別化

FY2022 業績予想

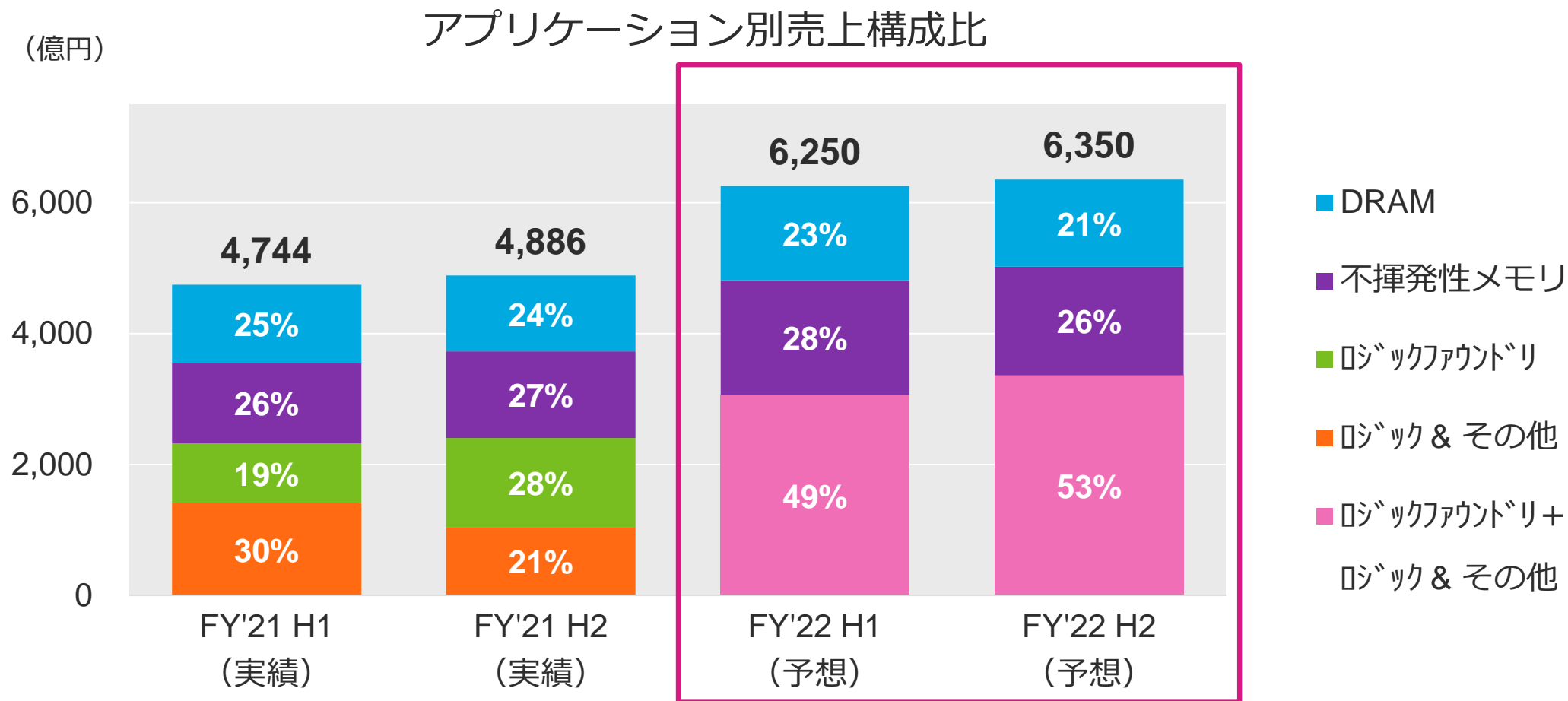
FY2022 業績予想

(億円)

	FY2021 (実績)	FY2022 (予想)			
		H1	H2	通期	通期 対前期増減
売上高	13,991	8,400	8,600	17,000	-
SPE	13,152	8,140	8,290	16,430	-
FPD	837	260	310	570	-
売上総利益	5,649	3,650	3,740	7,390	-
下段：売上総利益率	40.4%	43.5%	43.5%	43.5%	-
販管費	2,442	1,470	1,500	2,970	-
営業利益	3,206	2,180	2,240	4,420	-
下段：営業利益率	22.9%	26.0%	26.0%	26.0%	-
税金等調整前当期純利益	3,170	2,180	2,240	4,420	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,429	1,630	1,670	3,300	-
1株当たり当期純利益 (円)	1,562.20	1,047.89	-	2,121.49	-

過去最高の売上高、利益を見込む

FY2022 SPE部門 新規装置売上予想

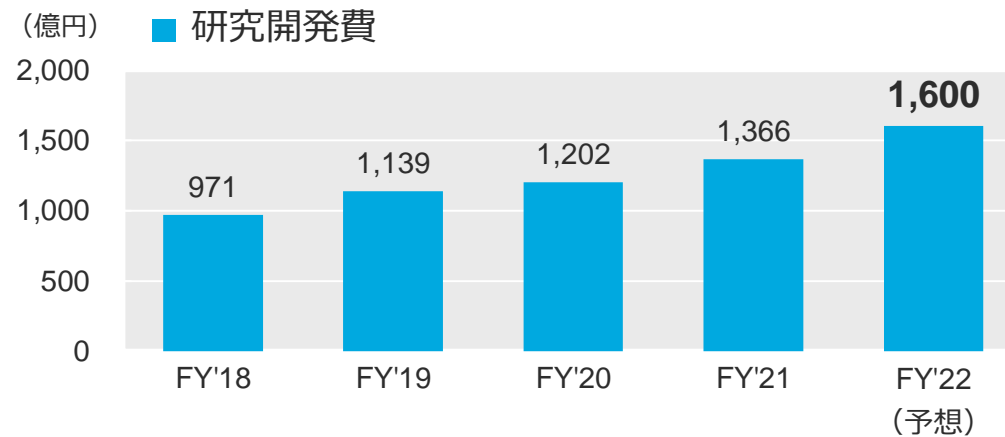


過去最高であったFY2021を大幅に上回る見込み

グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高を含んでいません。

FY2022 研究開発費・設備投資計画

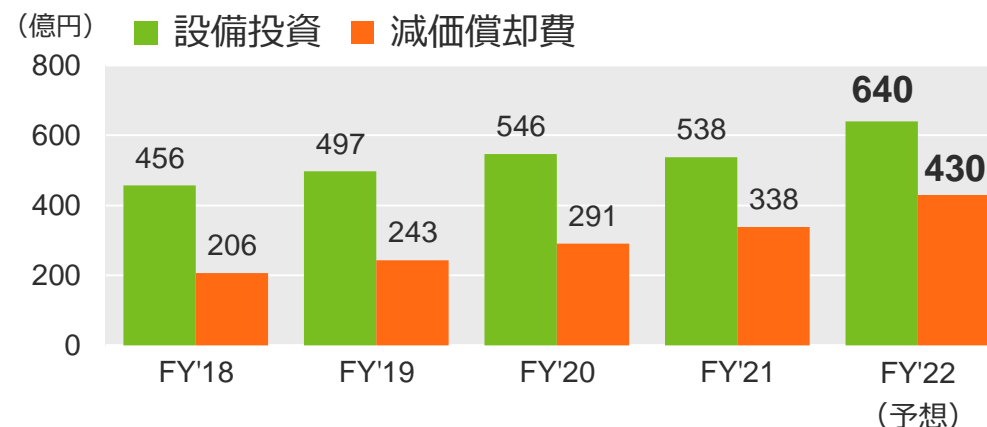
- 研究開発費 1,600億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 640億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 430億円



宮城県黒川郡：建設費約70億円
(2021年9月 竣工予定)



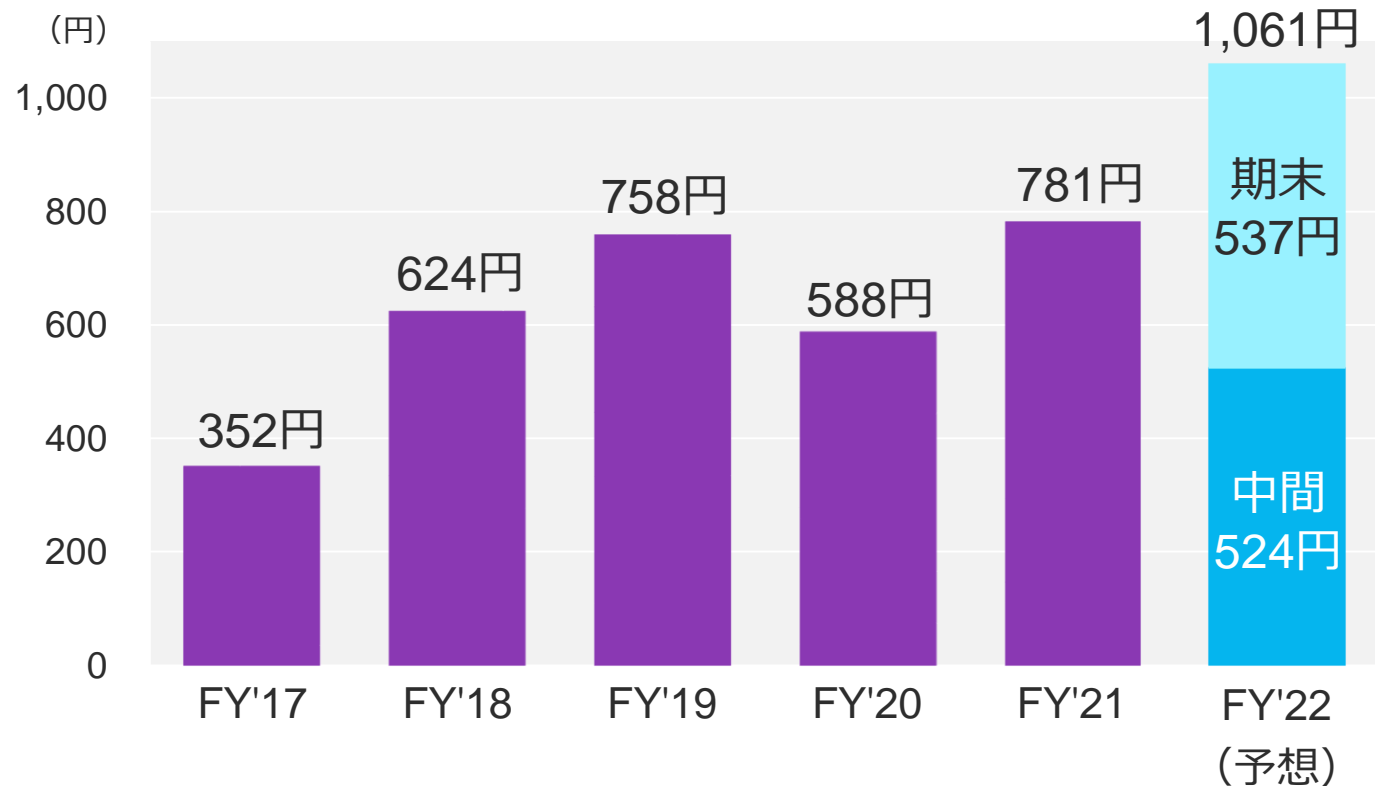
山梨県韮崎市：建設費約110億円
(2023年春 竣工予定)



拡大する市場と多様化する最新技術ニーズを見据え、
研究開発、設備投資を加速

FY2022 配当予想

1株当たり配当金



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

1株当たりの配当金は、配当性向 50%に沿って1,061円を予定

中期経営計画

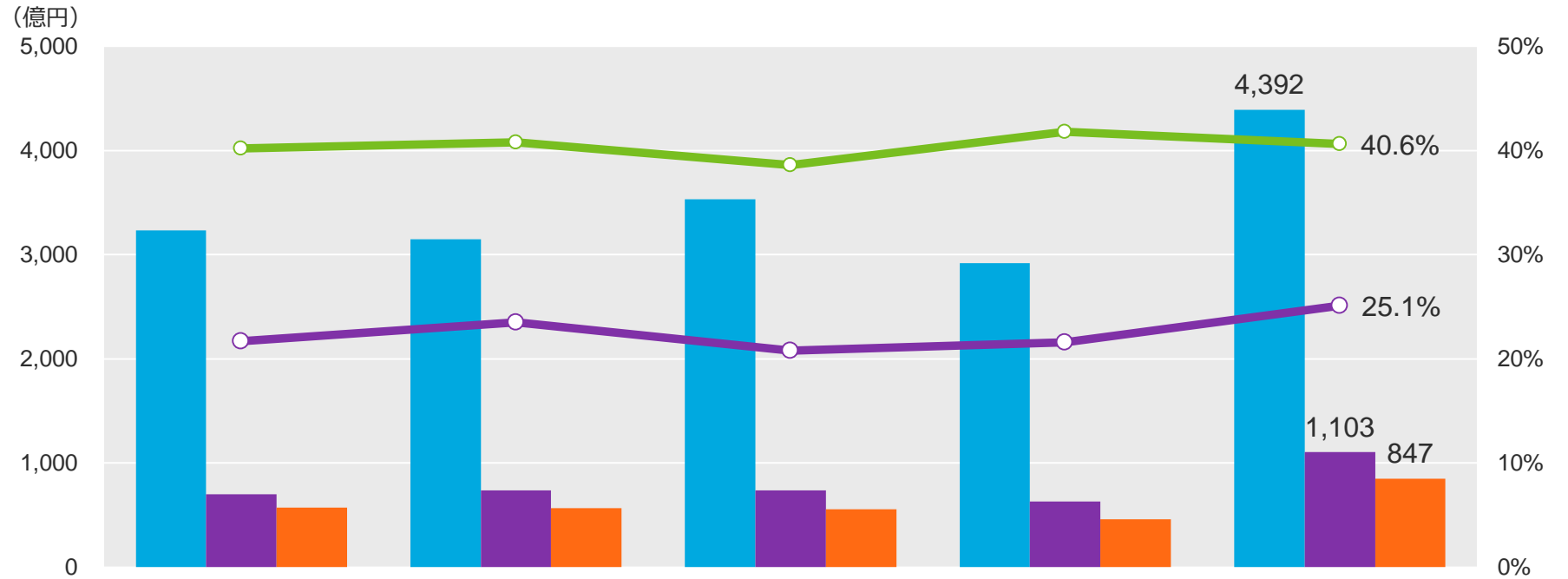
(億円)

	FY2021 (実績)	FY2022 (予想)	By FY2024 (計画)		
売上高	13,991	17,000	15,000	17,000	20,000
売上総利益	5,649	7,390	6,500	7,400	8,900
下段：売上総利益率	40.4%	43.5%	43.3%	43.5%	44.5%
販管費	2,442	2,970	2,520	2,640	2,900
下段：売上高販管費比率	17.5%	17.5%	16.8%	15.5%	14.5%
営業利益	3,206	4,420	3,980	4,760	>6,000
下段：営業利益率	22.9%	26.0%	26.5%	28.0%	>30.0%
ROE	26.5%	--	>30%		

財務モデルに変更なし
達成に向けて順調に進捗

補足資料

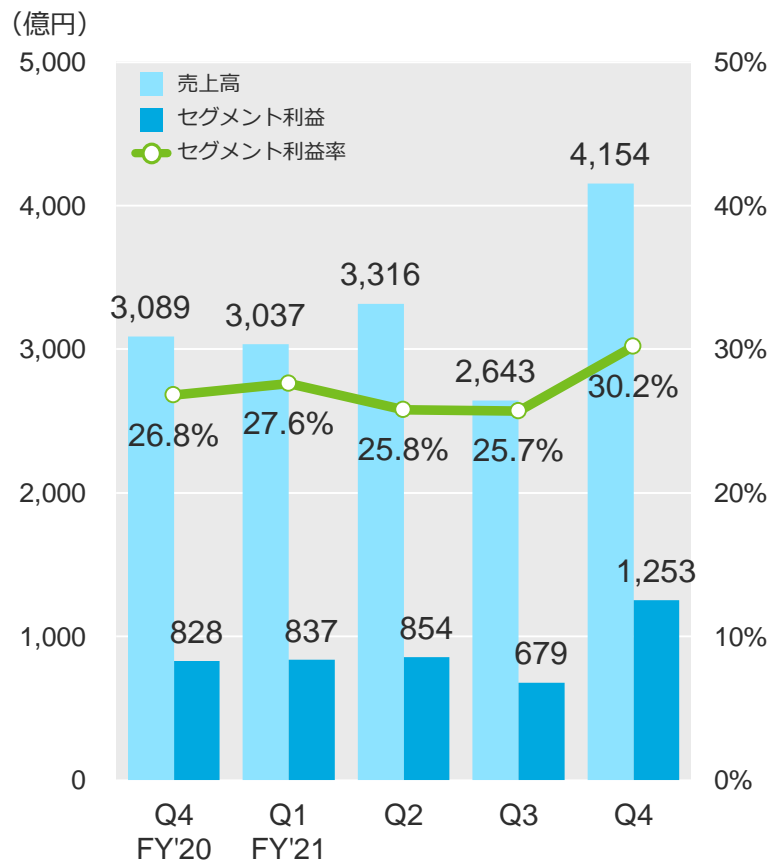
損益状況 (四半期)



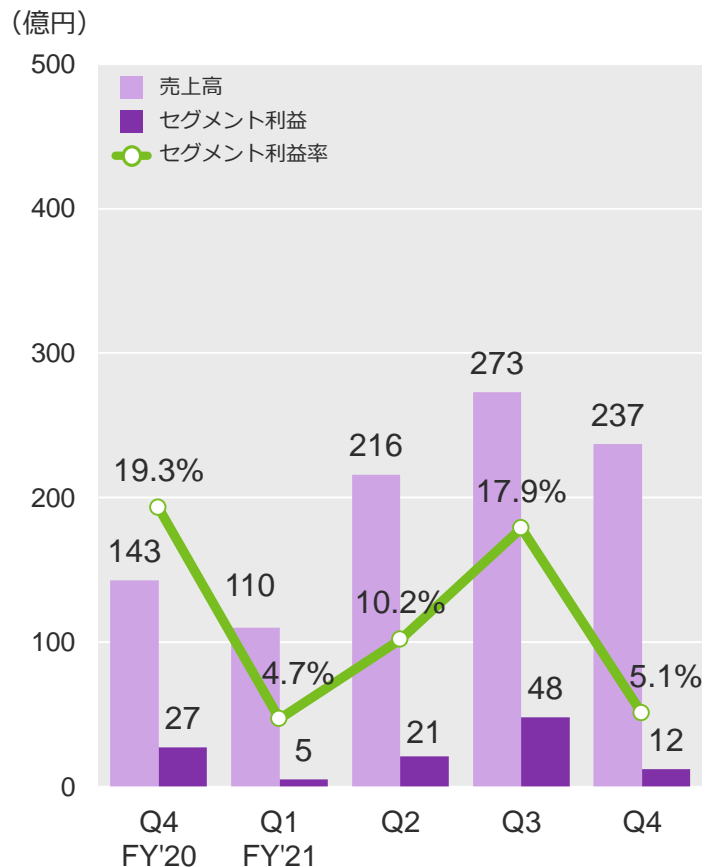
	Q4 FY'20	Q1 FY'21	Q2	Q3	Q4
売上高	3,233	3,148	3,533	2,917	4,392
営業利益	701	738	735	628	1,103
親会社株主に帰属する当期純利益	571	564	555	461	847
売上総利益率	40.2%	40.8%	38.6%	41.8%	40.6%
営業利益率	21.7%	23.5%	20.8%	21.6%	25.1%

セグメント情報（四半期）

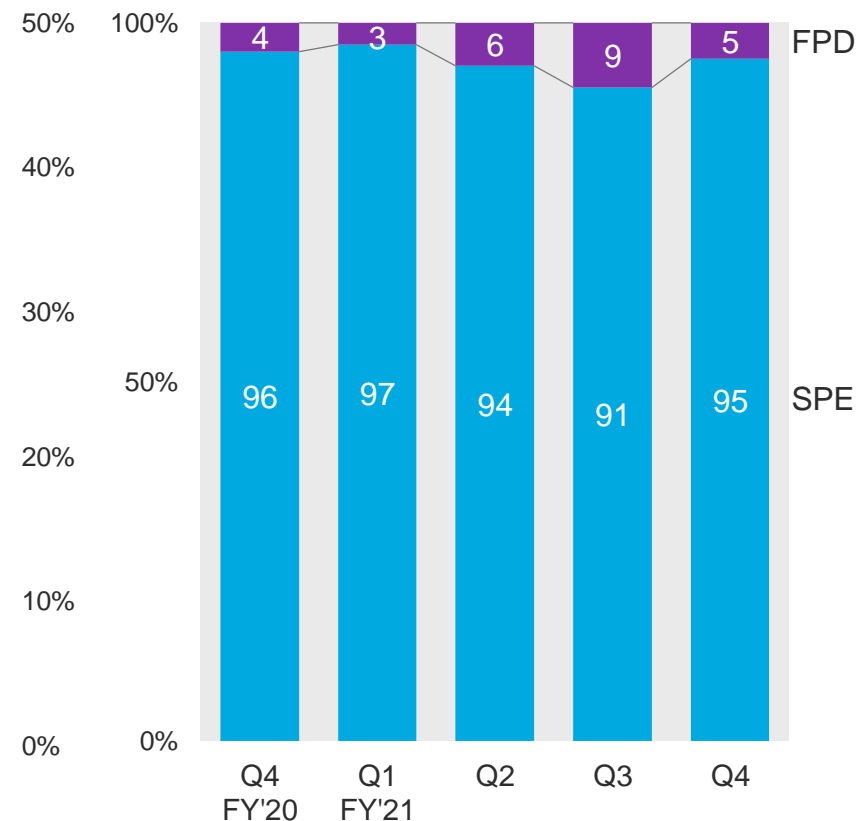
SPE（半導体製造装置）



FPD（フラットパネルディスプレイ製造装置）



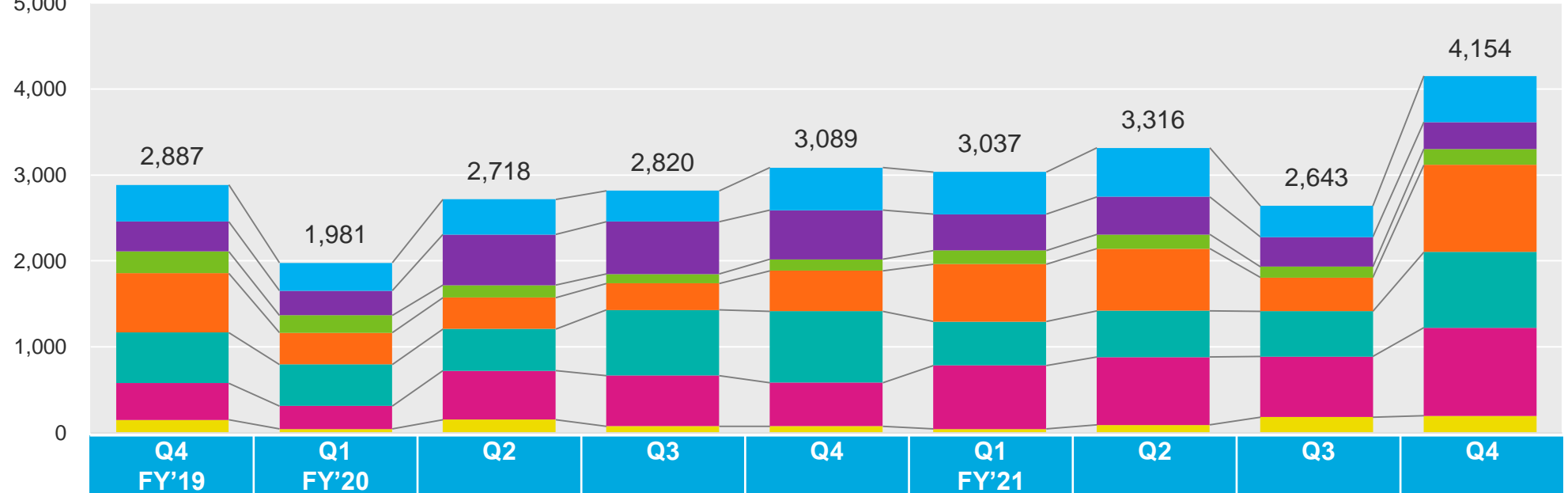
売上構成比率



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究又は要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

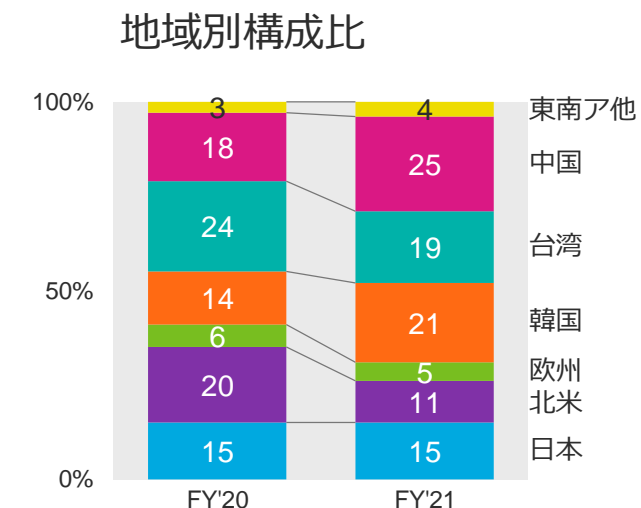
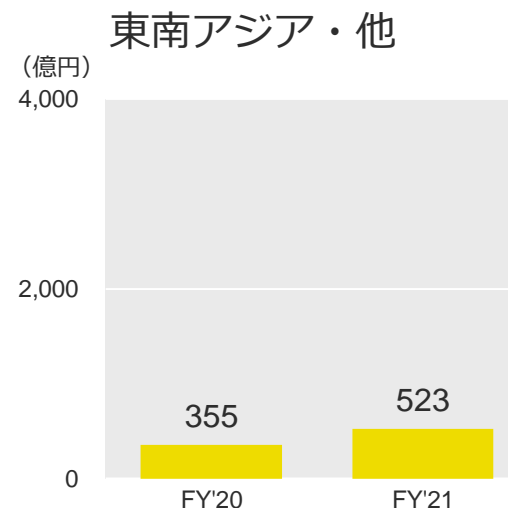
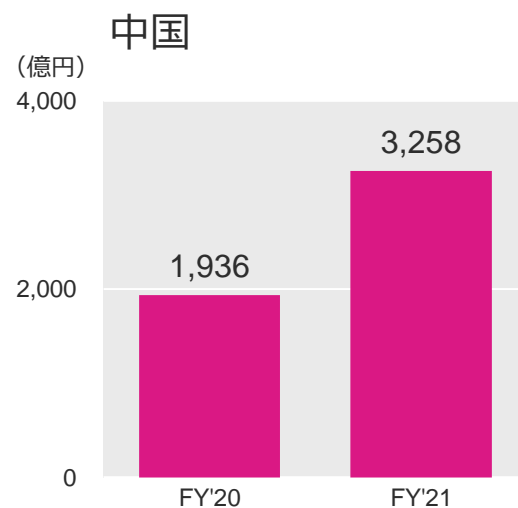
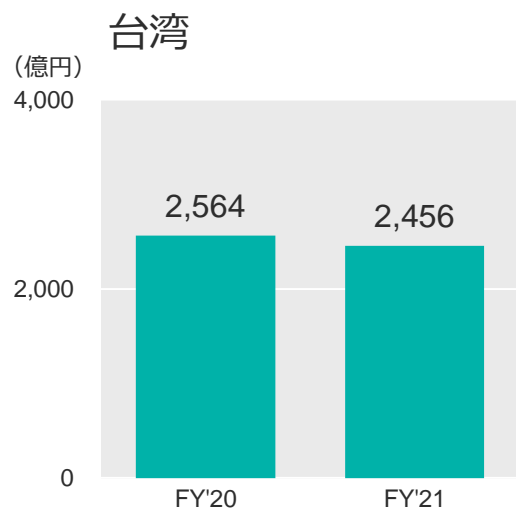
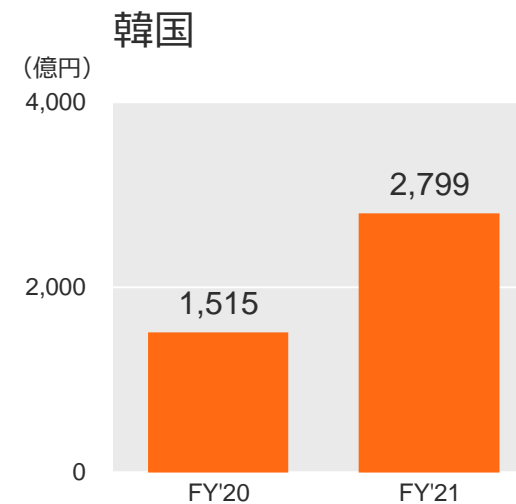
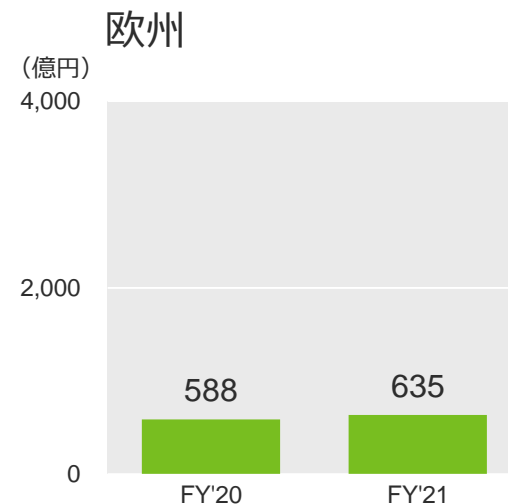
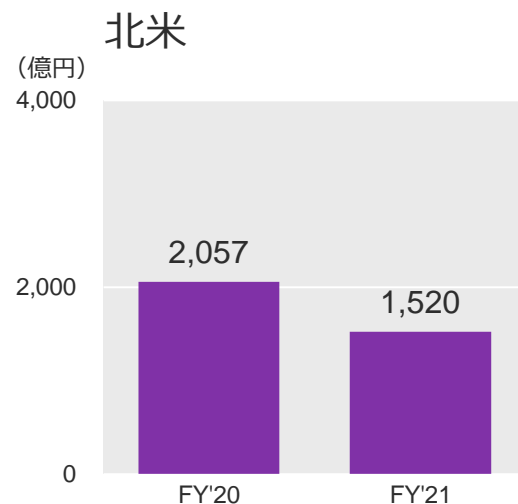
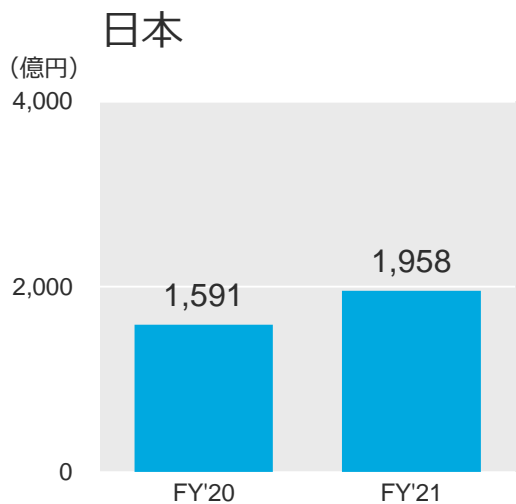
SPE部門 地域別売上高 (四半期)

(億円)
5,000

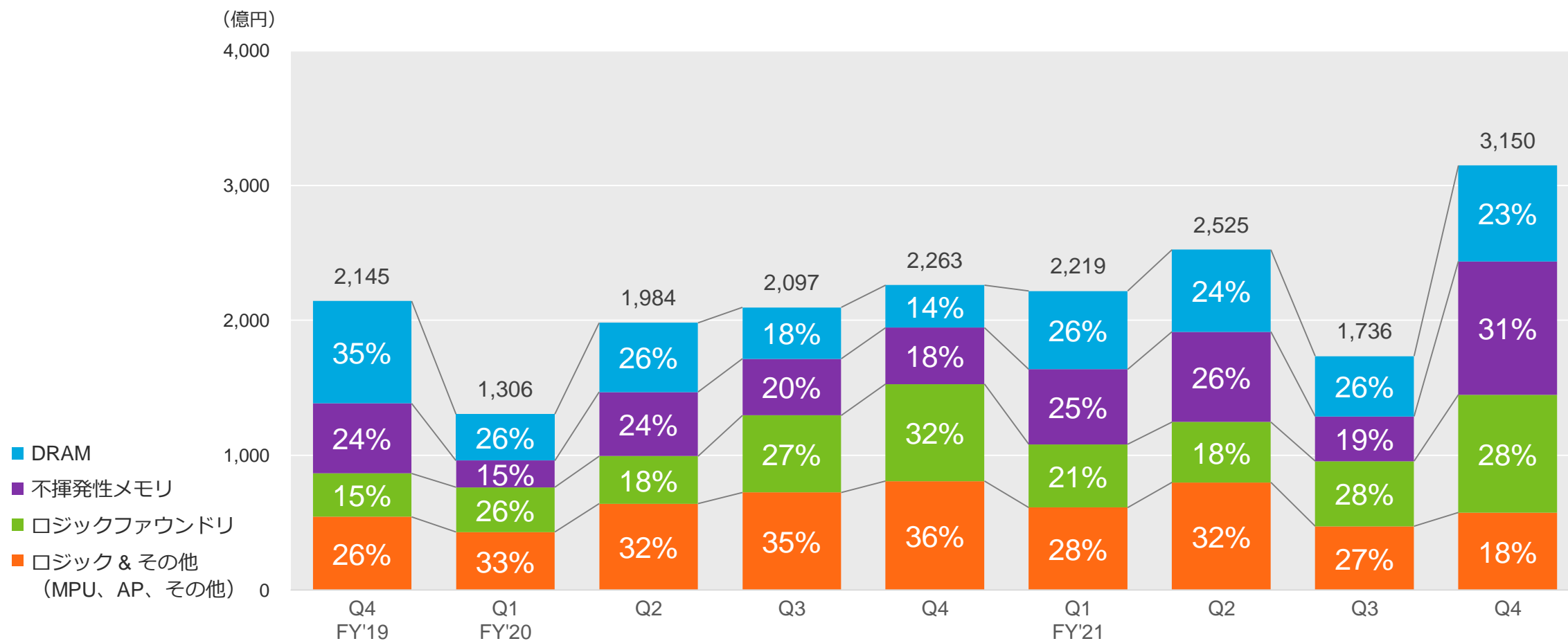


	Q4 FY'19	Q1 FY'20	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'21	Q2	Q3	Q4
日本	427	325	410	359	496	491	568	361	536
北米	347	285	588	610	572	423	440	345	312
欧州	253	202	144	108	133	157	163	127	186
韓国	689	369	364	310	471	670	721	393	1,014
台湾	591	483	487	762	831	509	539	525	882
中国	425	270	568	591	506	739	791	705	1,022
東南アジア・他	152	44	155	77	77	46	92	184	200

SPE部門 地域別売上高

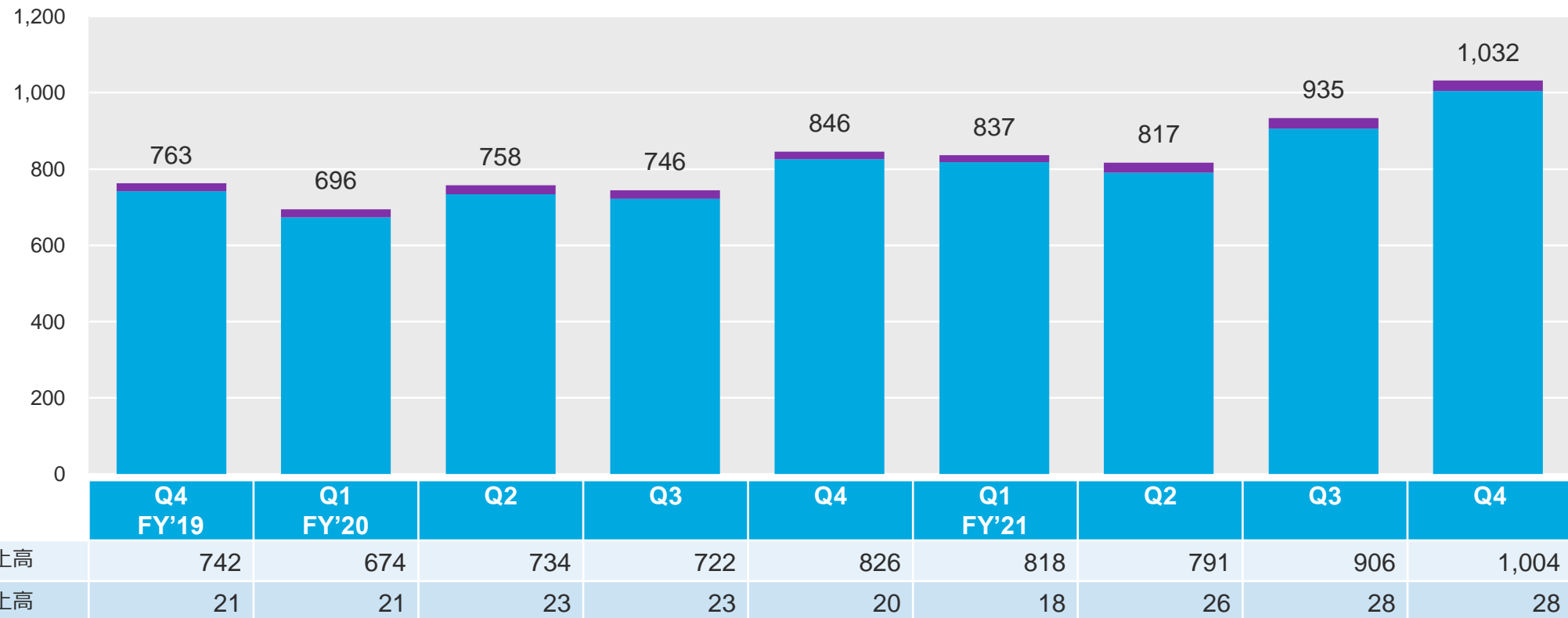


SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



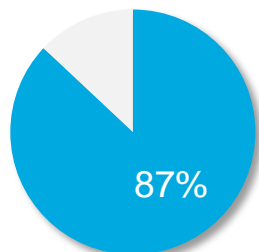
フィールドソリューション売上高（四半期）

(億円)

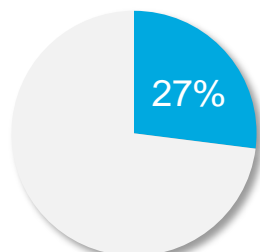


TEL 主要プロダクト 世界市場シェア (CY2020)

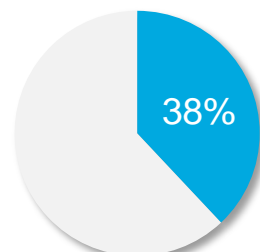
半導体製造装置



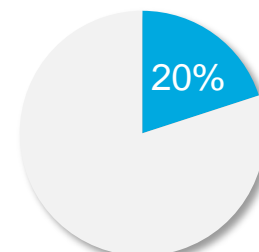
コータ/デベロッパ



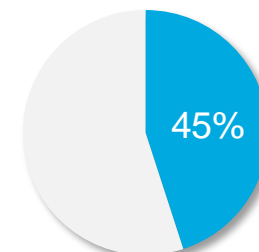
ドライエッチング装置



成膜装置

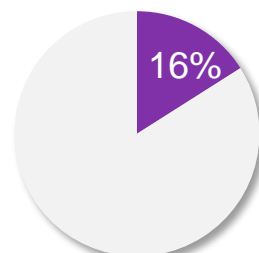


洗浄装置



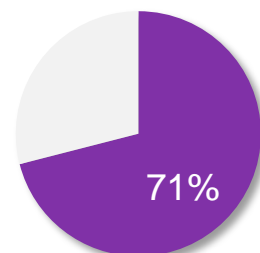
ウェーハプローバ*

FPD製造装置 (FY2021)

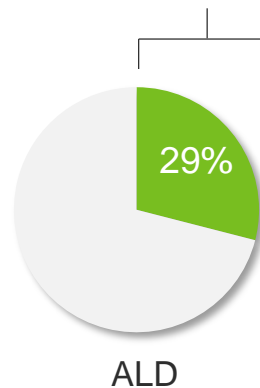


FPDコータ/デベロッパ

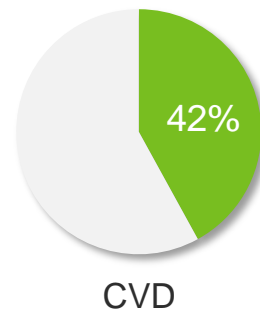
出所 (FPD) : 当社推定



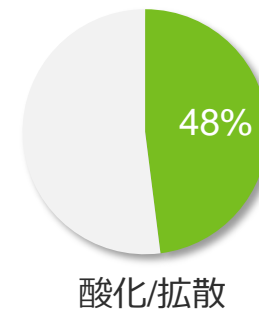
FPDプラズマエッチング装置



ALD



CVD



酸化/拡散

出所

SPE (ウェーハプローバを除く) : Gartner, "Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2020", Bob Johnson, Gaurav Gupta, 8 April 2021 図はガートナーリサーチに基づき、東京エレクトロンが作成。

コータ/デベロッパ: Photoresist Processing (Track), ドライエッチング装置: Dry Etch, 成膜装置: Tube CVD + Atomic Layer Deposition Tools + Oxidation/ Diffusion Furnaces + Nontube LPCVD, ALD: Atomic Layer Deposition Tools, CVD: Tube CVD + Nontube LPCVD, 酸化/拡散: Oxidation/diffusion Furnaces, 洗浄装置: Single Wafer Processors + Wet Stations + Batch Spray Processors + Scrubbers + Other Clean Equipment

* SPE (ウェーハプローバ) : VLSI Research, April 2021
図はVLSI Researchに基づき、東京エレクトロンが作成。

TEL™

TOKYO ELECTRON